

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



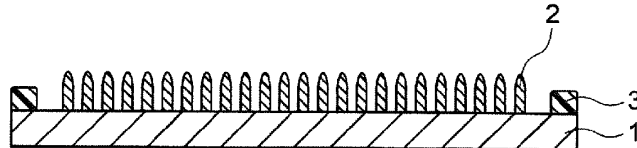
(10) 国際公開番号

WO 2023/189168 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 5/00 (2006.01)
B32B 3/30 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
B32B 7/025 (2019.01) C09J 201/00 (2006.01)
B32B 37/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/007781
- (22) 国際出願日: 2023年3月2日(02.03.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-051524 2022年3月28日(28.03.2022) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中西 勇人 (NAKANISHI Hayato); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 前田 淳 (MAEDA Jun); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 藤本 泰史 (FUJIMOTO Hironobu); 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 前田・鈴木国際特許弁理士法人 (MAEDA & SUZUKI); 〒1010003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5番5号 岩波書店一ツ橋ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,

(54) Title: WORKPIECE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: ワークの加工方法



(57) Abstract: [Problem] To provide a workpiece processing method capable of reducing TTV of a workpiece. [Solution] A workpiece processing method comprises: a step for adhering a surface protective sheet to a surface of a workpiece having a front surface and a rear surface; and a step for grinding the rear surface of the workpiece with the surface protective sheet adhered thereto, wherein the surface of the workpiece has a bump electrode, in the step for adhering the surface protective sheet, a projecting pattern is formed in a region different from a region at an outer periphery of the surface of the workpiece where the bump electrode is formed, the surface protective sheet is adhered to bury the bump electrode, and Hb and H1, where Hb is a height of the bump electrode and H1 is a height of the projecting pattern, satisfy the relationship $Hb/8 < H1 < Hb/1.5$.

(57) 要約: 【課題】ワークのTTVを小さくできるワークの加工方法を提供すること。【解決手段】表裏面を有するワークの表面に表面保護シートを貼付する工程と、表面保護シートが貼付されたワークの裏面を研削する工程と、を有し、ワークの表面がバンプ電極を有し、表面保護シートを貼付する工程において、ワークの表面の外周部であってバンプ電極が形成されている領域とは異なる領域に凸状パターンが形成されており、表面保護シートは、バンプ電極を埋め込むように貼付され、バンプ電極の高さをHbとし、凸状パターンの高さをH1とした時に、HbおよびH1が、 $Hb/8 < H1 < Hb/1.5$ である関係を満足するワークの加工方法である。

[続葉有]

WO 2023/189168 A1

SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))